

## 2026年3月期 第4四半期 決算説明会 Q&A

### ■ 質問一覧

- Q1 今回、3Q から 4Q にかけて受注が減少している。この 3Q から 4Q にかけての受注状況について、アプリケーション別や地域別の状況をもう少し詳しく教えてほしい。特に地域別の受注状況を説明してほしい。
- Q2 今期の受注見通しについて伺いたい。HBM は下期から、PLP も下期からの立ち上がりに見える一方、17 ページの受注予想では四半期ごとのばらつきがない。この背景について教えてほしい。
- Q3 17 ページの表について、下期には HBM や PLP 関連案件の立ち上がりを見込む一方、それ以外の分野は上期偏重にも見える。この表は、分野別の上下期の強弱を明確に示したものではない、という理解でよいか。
- Q4 利益率について確認したい。17 ページでは「利益率は段階的な改善を見込む」とある一方、上下期の利益水準は概ね同程度に見受けられる。この表現の背景について教えてほしい。
- Q5 HBM 向けについて、2025 年度は 2Q 以降に受注が立ち上がっていると理解している。4Q 以降もこの流れは継続し、下期にかけて加速するイメージなのか。また、4Q 案件も一定程度前倒して受注できているのか。
- Q6 HBM について、2026 年度は、2025 年度を上回る水準で推移するイメージなのか。
- Q7 HBM について、中間決算時に数年間で 30～45 台程度との見通しを示されていたが、現時点でもその認識に変化はないのか。
- Q8 汎用メモリー向け需要について、今年度はどのように見ているのか。
- Q9 コンプレッションではなく、トランスファ装置の実績が 2025 年度に大きく増加した背景について教えてほしい。
- Q10 INNOMS について、どのような点が革新的なのか。
- Q11 INNOMS について、構造面での大きな変革によって高生産性を実現しているという理解でよいか。

- Q12 地域別受注について伺いたい。HBM 関連では韓国受注の比率が高いと理解しているが、今後、本格的に需要が立ち上がる局面では、2024年3月期の受注規模まで再び拡大するイメージなのか。それとも、より段階的な立ち上がりを想定しているのか。
- Q13 PLP 向けモールディング装置について、ロジック向け需要やパッケージ全体のモールディングも含め、今後の成長機会をどのように見ているのか。
- Q14 500 ミリ PLP 関連について、今後さらに事業機会拡大を期待してよいか。
- Q15 HBM 向けに加え、ロジックやメモリーを組み合わせたパッケージ領域でも、MUF のビジネス機会拡大を期待してよいか。
- Q16 新製品の主なターゲットとなるデバイスやパッケージを教えてください。また、生産性向上による付加価値をどのように取り込む考えなのか。
- Q17 INNOMS について、消耗品材料を 25%削減できるとの説明について、何との比較になるのか。
- Q18 INNOMS について、リリースフィルム使用量が減少することで、御社業績への影響はどのように考えればよいか。
- Q19 INNOMS について、価格設定については、従来機比で 2~3 割程度引き上げるようなイメージなのか。
- Q20 INNOMS について、新規投資だけでなく、既存設備の置き換え需要もターゲットになっているという理解でよいか。
- Q21 INNOMS について、マージン水準はどのように理解すればよいか。
- Q22 INNOMS について、本製品は既に顧客への提案・評価段階に入っているのか。それとも、現時点ではコンセプト提示に留まる状況なのか。
- Q23 INNOMS について、実際の評価開始および受注タイミングについては、今年度中を想定しているという理解でよいか。
- Q24 今年度の受注・売上計画について、四半期ごとの大きな受注変動は想定していないという理解でよいか。
- Q25 今年度は、受注・売上ともに比較的平準化された推移を想定しているという理解でよいか。
- Q26 中国向け受注は第 4 四半期にかけて拡大しているが、この勢いは今年度も継続すると見ているのか。それとも、一巡感を想定しているのか。

- Q27 利益率について、上下期で製品ミックスに大きな変化はないのか。利益水準は概ね横ばいに見えるが、その背景を教えてください。
- Q28 レーザーフロントについて、今期は特定案件による寄与を見込んでいるとのことだが、来期以降も継続性のある事業機会として期待できるのか。

## ■ Q&amp;A

Q1 今回、3Q から 4Q にかけて受注が減少している。この 3Q から 4Q にかけての受注状況について、アプリケーション別や地域別の状況をもう少し詳しく教えてほしい。特に地域別の受注状況を説明してほしい。

A1 台湾は、4Q 計上予定案件の一部が前倒しで 3Q に入ったことで、3Q に受注が集中した反動が出ている。日本は、3Q に大阪大学向け核融合設備案件の特別受注があったことに加え、一部案件の期ずれ影響もあり、4Q は減少した。

このように、3Q 偏重の反動で 4Q は減少したものの、足元の受注環境には回復の兆しが見られており、一時的な変動と見ている。

[▲TOP](#)

Q2 今期の受注見通しについて伺いたい。HBM は下期から、PLP も下期からの立ち上がりに見える一方、17 ページの受注予想では四半期ごとのばらつきがない。この背景について教えてほしい。

A2 HBM を含むメモリー分野では、前工程投資が継続した一方、足元では組立工程向け工場の建設段階に入っている。今年後半の工場完成後、本格的な受注立ち上がりを見込んでいる。一方で、中東情勢など外部環境の変化や工場建設スケジュールの影響により、不確実性も残る状況である。

受注残高は今期売上高の半分弱の水準にあり、受注自体は概ね計画通りに進捗している。ただし、四半期ごとの変動余地はあると見ている。

[▲TOP](#)

Q3 17 ページの表について、下期には HBM や PLP 関連案件の立ち上がりを見込む一方、それ以外の分野は上期偏重にも見える。この表は、分野別の上下期の強弱を明確に示したのではない、という理解でよいか。

A3 HBM 関連需要については既に受注を獲得しており、年間を通じて先取り受注をいただいている。そのため、現時点では大きな偏りや突発的な変動は想定していない。

[▲TOP](#)

Q4 利益率について確認したい。17 ページでは「利益率は段階的な改善を見込む」とある一方、上下期の利益水準は概ね同程度に見受けられる。この表現の背景について教えてほしい。

A4 売上高の増加に伴う利益増は見込んでいる。一方で、市場ポジション強化を優先した戦略的対応も織り込んでおり、利益率の回復は段階的なものを想定している。

[▲TOP](#)

Q5 HBM 向けについて、2025 年度は 2Q 以降に受注が立ち上がっていると理解している。4Q 以降もこの流れは継続し、下期にかけて加速するイメージなのか。また、4Q 案件も一定程度前倒しで受注できているのか。

A5 今年度のフォーキャストは既に顧客から受領しており、現時点で突発的な需要増加は想定していない。一方で、生産能力は逼迫しているため、四半期中で追加受注が発生する可能性はあると見ている。

[▲TOP](#)

Q6 HBM について、2026 年は、2025 年を上回る水準で推移するイメージなのか。

A6 これまでは一部顧客による投資が中心であったが、昨年末頃からは他社でも HBM 向け投資が加速している。そのため、受注については前年を上回る水準を期待している。

[▲TOP](#)

Q7 HBM について、中間決算時に数年間で 30~45 台程度との見通しを示されていたが、現時点でもその認識に変化はないのか。

A7 現時点でも概ねその水準を想定している。一方で、顧客側ではさらに多くの装置導入ニーズがあるものの、工場建設の遅れや国によっては電力不足などの影響で計画が遅延しており、装置導入時期は工場完成の進捗に影響されると見ている。

[▲TOP](#)

Q8 汎用メモリー向け需要について、今年度はどのように見ているのか。

A8 台湾 OSAT 顧客を中心に強い需要が継続している。一方で、足元では HBM 向けに生産が集中しており、汎用メモリー向けの供給は不足している。今後、前工程側の増産対応が一巡すれば、汎用メモリー向け需要も徐々に回復すると見ている。

[▲TOP](#)

Q9 コンプレッションではなく、トランスファ装置の実績が 2025 年度に大きく増加した背景について教えてほしい。

A9 中国関連を含め、主にパワー半導体やアナログ半導体向け需要が強かったことが背景にある。一方、ハイエンド向けコンプレッション装置は、2025 年度はプロトタイプ案件が中心であった。今後は量産設備への移行が進み、今年から来年にかけて量産投資が本格化すると見ている。

[▲TOP](#)

Q10 INNOMS について、どのような点が革新的なのか。

A10 顧客が求めているのは、同じ設置面積で生産性を倍増させることである。工場スペース制約が強まる中、同一スペースでの高生産性化は、置き換え需要やコスト低減につながる。特に、量産コストを約 50% 削減できる点が大きな訴求ポイントとなっている。

[▲TOP](#)

Q11 INNOMS について、構造面での大きな変革によって高生産性を実現しているという理解でよいか。

A11 その通りである。高密度化により、従来と同じ設置スペースで生産性を倍増させている。当社がこれまで蓄積してきた技術をベースに開発した製品である。

[▲TOP](#)

Q12 地域別受注について伺いたい。HBM 関連では韓国受注の比率が高いと理解しているが、今後、本格的に需要が立ち上がる局面では、2024年3月期の受注規模まで再び拡大するイメージなのか。それとも、より段階的な立ち上がりを想定しているのか。

A12 2024年3月期は短期間で受注が集中した特殊な局面であった。現時点では、HBM 関連が一気に立ち上がるというより、分散しながら積み上がるイメージを持っている。一方で、汎用メモリーについては供給不足が続いており、投資タイミング次第では一時的に集中する可能性もあると見ている。

[▲TOP](#)

Q13 PLP 向けモールド装置について、ロジック向け需要やパッケージ全体のモールドも含め、今後の成長機会をどのように見ているのか。

A13 これまでの AI 投資はデータセンター向けが中心であり、それに伴い HBM 需要も拡大してきた。今後は、フィジカル AI やスマートフォン、PC など幅広い分野で AI チップ搭載が進むと見ている。足元では、推論用途向け AI GPU の需要拡大を背景に、コスト低減ニーズから 500~600 ミリ級の大判パネル活用が広がると見ている。

[▲TOP](#)

Q14 500 ミリ PLP 関連について、今後さらに事業機会拡大を期待してよいか。

A14 当社の真空成形技術を活用した MUF 技術は、AI 向けなど発熱量の大きい半導体において、放熱性能改善と工程削減によるコスト低減の両面で優位性を持っているため、PLP 装置の採用拡大を見込んでいる。

[▲TOP](#)

Q15 HBM 向けに加え、ロジックやメモリーを組み合わせたパッケージ領域でも、MUF のビジネス機会拡大を期待してよいか。

A15 前期はプロトタイプ案件中心で業績寄与は限定的であったが、次世代 AI では放熱性能が課題となっており、当社技術の評価も進んでいる。今後の採用拡大を期待している。

[▲TOP](#)

Q16 新製品の主なターゲットとなるデバイスやパッケージを教えてください。また、生産性向上による付加価値をどのように取り込む考えなのか。

A16 INNOMS は、100 ミリ×300 ミリを MAX としてストリップタイプ用の装置として、現行 PMC シリーズ比で約 2 倍の生産性を実現している。  
用途としては、メモリー向け MAP パッケージに加え、QFN や RF モジュール向けも対象となる。また、放熱性向上ニーズを背景に、コンプレッション成形でしか対応できない領域も今後のターゲットになると見ている。

[▲TOP](#)

Q17 INNOMS について、消耗品材料を 25%削減できるとの説明について、何との比較になるのか。

A17 当社従来機との比較である。リリースフィルムを使用している工程において、従来比で使用量を 25%削減できる点を示している。

[▲TOP](#)

Q18 INNOMS について、リリースフィルム使用量が減少することで、御社業績への影響はどのように考えればよいか。

A18 消耗品売上は減少する一方、新製品では生産性が約 2 倍に向上するため、全体としては業績へのプラス効果を見込んでいる。

[▲TOP](#)

Q19 INNOMS について、価格設定は、従来機比で 2～3 割程度引き上げるようなイメージなのか。

A19 価格設定については、顧客側で過度なコスト負担となる水準では受け入れが難しいと考えている。一方で、工場スペース不足が課題となる中、設備集約による生産性向上メリットは大きい。そのため、置き換え需要も含め、顧客との協議を進めている段階である。

[▲TOP](#)

Q20 INNOMS について、新規投資だけでなく、既存設備の置き換え需要もターゲットになっているという理解でよいか。

A20 その認識である。

[▲TOP](#)

Q21 INNOMS について、マージン水準はどのように理解すればよいか。

A21 通常のコンプレッション装置以上の利益率を目指している。現状はまだプロトタイプ機段階であるため、今後はコスト低減も進めながら、さらなる利益率向上を図っていく考えである。

[▲TOP](#)

Q22 INNOMS について、本製品は既に顧客への提案・評価段階に入っているのか。それとも、現時点ではコンセプト提示に留まる状況なのか。

A22 一部顧客に対しては既に提示しており、半導体業界ではフィールド評価が必要となるため、現在は評価開始直前の段階にある。

[▲TOP](#)

Q23 INNOMS について、実際の評価開始および受注タイミングについては、今年度中を想定しているという理解でよいか。

A23 その認識である。

[▲TOP](#)

Q24 今年度の受注・売上計画について、四半期別の大きな受注変動は想定しないという理解でよいか。

A24 前期は関税問題などの影響で受注変動が大きかったが、今年度は HBM 関連を中心に顧客フォーキャストを織り込んだ計画としており、現時点では比較的安定した推移を想定している。

[▲TOP](#)

Q25 今年度は、受注・売上ともに比較的平準化された推移を想定しているという理解でよいか。

A25 その認識である。受注・売上の変動が大きい場合、工場運営面での負荷も大きくなるため、今期については一定程度平準化された前提で計画を立てている。

[▲TOP](#)

Q26 中国向け受注は第4四半期にかけて拡大しているが、この勢いは今年度も継続すると見ているのか。それとも、一巡感を想定しているのか。

A26 中国では、民生分野を含めサプライチェーンのエコシステムが国内で完結しており、依然として供給不足感が続いていると認識している。そのため、当面は引き続き堅調な受注が継続すると見ている。

[▲TOP](#)

Q27 利益率について、上下期で製品ミックスに大きな変化はないのか。利益水準は概ね横ばいに見えるが、その背景を教えてください。

A27 前期は需要変動が大きく、ハイエンド製品よりミドルエンドのトランスファ装置比率が高まったことで、利益率低下要因となった。今期は、コンプレッション装置・トランスファ装置ともに比較的バランスの取れた構成となっており、一定水準の利益を確保できると見ている。

[▲TOP](#)

Q28 レーザーフロントについて、今期は特定案件による寄与を見込んでいるとのことだが、来期以降も継続性のある事業機会として期待できるのか。

A28 特殊案件であるため、来期以降も継続的に発生する前提では見ていない。一方で、本案件を通じて TOWA の技術力を認知いただくことで、将来的な採用機会につながる可能性はある。

[▲TOP](#)